**第二届集成电路产业技术创新奖推荐表**

|  |  |
| --- | --- |
| **奖励名称** |  |
| **申报单位** |  |
| **奖励类型** | 请在下面“□”内打“√”技术创新奖 □ 成果产业化奖 □产业链合作奖 □ 突出贡献奖 □ |
| **技术类型** | 请在下面“□”内打“√”设计□ 制造□ 封测□ 装备□ 材料□ 零部件□ |
| **奖励团队****及****主要人员****（包括姓名、职务/职称等）** |  |
| **联系人** |  | **职务** |  |
| **座机** |  | **手机** |  |
| **E-mail** |  | **传真** |  |
| 奖励项目简介 |  |
| **奖项完成单位声明：** **本单位保证所提供的材料真实有效，且不存在任何违反国家相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。**单位盖章： 单位负责人签字： 年 月 日 |
| **推荐意见：** **推荐单位盖章（推荐人签字）：**年 月 日注：如推荐者为个人，只需人个签字。 |

**奖励项目简介填写须知：**

1. 技术创新奖应至少载明以下内容：
2. 重大技术创新简介，包括技术创新点、技术指标、技术先进性等。
3. 技术应用情况，包括应用领域、用户情况以及市场表现等。
4. 发明专利及学术论文，包括专利名称、专利号；论文题目、期刊名称及卷期号等。
5. 成果产业化奖应至少载明以下内容：
6. 成果简介，包括成果的创新性、主要性能和技术指标等。
7. 成果产业化情况，包括实现批量生产时间、产品良率、客户应用情况、实现销售收入，利税等。
8. 产业链合作奖应至少载明以下内容：
9. 产业链合作应至少包括以下内容之一：在国内制造厂流片；推进国产装备、材料、零部件量产应用；与上下游企业合作解决关键技术问题；高校、研究机构、企业等技术合作等。
10. 具体描述在产业链合作、促进协同创新等方面所做出的突出贡献。
11. 取得的合作效益，包括经济效益、用户评价、市场表现等。
12. 突出贡献奖应至少载明以下内容：
13. 在技术创新、成果产业化、密切产业链合作等活动中做出的具体贡献。
14. 突出贡献个人在行业中的影响力等。
15. 填写内容字数不限，表格不够可附页。